WS 2015/2016 Ausgabe am: 01.02.2016

Übungsblatt 14

Aufgabe 1) MOSFET

Ein n-Kanal MOSFET besitzt eine Gate-Kapazität $C_G = C_I = bLC_I' = 1$ pF, wobei C_I' den Kapazitätsbelag des Gates beschreibt. Die Kanallänge beträgt L = 2 μ m und die Elektronenbeweglichkeit im Kanal liegt bei $\mu_n = 350$ cm²/Vs. Der FET wird an der Sättigungsgrenze $U_{GS} = U_{DS} = 6$ V betrieben. Es wird angenommen, dass die Schwellenspannung bei $U_{th} = 0$ V liegt und dass das Gate-Oxid frei von Raumladungen ist.

- a) Wie groß ist der Drainstrom I_D im Abschnürbereich?
- b) Berechnen Sie für diesen Strom den örtlichen Verlauf des Kanalpotentials $U_K(y)$ an der Grenzfläche zwischen Halbleiter und Gate-Oxid. Die y-Achse verläuft von Drain in Richtung Source entlang des Inversionskanals.

Hinweis: Stellen Sie den Ausdruck für den Drainstrom allgemein als Funktion der Flächenladungsdichte im Kanal auf. Der Verlauf des elektrischen Feldes ergibt sich aus der ortsabhängigen Driftgeschwindigkeit. Dies führt auf eine Differentialgleichung für $U_K(y)$, die die folgende Form aufweist:

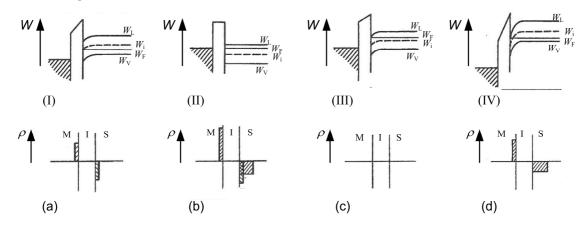
$$I_{\scriptscriptstyle D} = b\mu_{\scriptscriptstyle n} \frac{d}{dy} U_{\scriptscriptstyle K}(y) \cdot C_{\scriptscriptstyle I}' \big[U_{\scriptscriptstyle DS,Sat} - U_{\scriptscriptstyle K}(y) \big]$$

Nehmen Sie die Source-Elektrode als Potentialnullpunkt an.

c) Berechnen Sie den Verlauf der in Stromflussrichtung gerichteten E-Feldkomponente $E_y(y)$ im Kanal. Der formale Ausdruck ergibt eine unphysikalische Polstelle bei y = L. Erklären Sie dieses Phänomen qualitativ vor dem Hintergrund des Abschnürverhaltens des Transistors. Wie wird sich ein reales Bauteil an dieser Stelle tatsächlich verhalten?

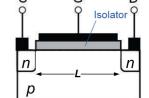
Aufgabe 2) MOSFET und MIS-Struktur

a) Im Folgenden sind vier verschiedene Metall-Isolator-Halbleiter-(MIS-)Strukturen skizziert. Ordnen Sie den Bandverläufen (I) bis (IV) die Ladungsträgerverteilungen (a) bis (d) zu. Bestimmen Sie dabei, welche Dotierung (n oder p) im Halbleiter vorliegt. W_F bezeichnet die Fermi-Energie, W_i die Mitte der Bandlücke.



b) Ordnen Sie die gezeigten Bandverläufe den folgenden Betriebszuständen der MIS-Struktur zu: Verarmung, Anreicherung, starke Inversion, Flachbandfall.

Bei einem *n*-Kanal MOSFET beträgt die Kanallänge $L=2 \, \mu \text{m}$, die Kanalbreite $b=15 \, \mu \text{m}$ (senkrecht zur Zeichenebene), und der Kapazitätsbelag des Gates wird mit $C'=6.9\cdot 10^{-8} \, \text{F/cm}^2$ angegeben.



Für eine Drain-Source-Spannung von $U_{\rm DS}=0.1~{\rm V}$ werden im ohmschen Bereich die folgenden Drainströme $I_{\rm D}$ gemessen:

Arbeitspunkt 1: $U_{GS} = 1.5 \text{ V}$, $I_D = 35 \mu\text{A}$; Arbeitspunkt 2: $U_{GS} = 2.5 \text{ V}$, $I_D = 75 \mu\text{A}$.

- c) Berechnen Sie für den oben beschriebenen MOSFET die Schwellenspannung $U_{\rm th}$ und die Elektronenbeweglichkeit $\mu_{\rm n}$ im Kanal.
- d) An das oben beschriebene Bauteil wird eine Gate-Source-Spannung von U_{GS} = 2,5 V angelegt. Berechnen Sie die Drain-Source-Spannung, bei welcher der Sättigungsbereich beginnt, sowie den Sättigungsstrom.

Aufgabe 3) Beleuchtete Halbleiterprobe

Eine $6 \,\mu m$ lange Siliziumprobe ist an beiden Enden metallisiert. Eine externe Spannung ist nicht angelegt. Die Probe wird räumlich inhomogen in einer Weise beleuchtet, dass die stationäre Überschussminoritätsträgerdichte $n'_{p}(x)$ den folgenden Verlauf zeigt:

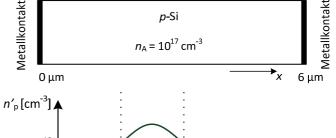
$$n'_{p}(x) = \begin{cases} 10^{25} \text{ m}^{-4}x & \text{für } 0 \text{ } \mu\text{m} \le x \le 2 \text{ } \mu\text{m} \\ 2,5 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3} - 0,5 \cdot 10^{31} \text{ m}^{-5} (x - 3 \text{ } \mu\text{m})^{2} & \text{für } 2 \text{ } \mu\text{m} < x \le 4 \text{ } \mu\text{m} \\ 10^{25} \text{ m}^{-4} (6 \text{ } \mu\text{m} - x) & \text{für } 4 \text{ } \mu\text{m} < x \le 6 \text{ } \mu\text{m} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

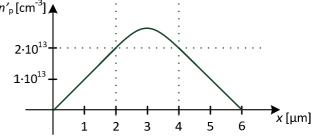
Die Probe ist *p*-dotiert mit einer Dichte von $n_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. Die Beweglichkeit der

Elektronen ist $\mu_n = 1600 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$, die der Löcher

$$\mu_{\rm p} = 800 \ \frac{{\rm cm}^2}{{\rm Vs}}$$
. Die Eigenleitungsträgerdichte

ist $n_{\rm i}=10^{10}~{\rm cm^{-3}}$ und die Diffusionslänge der Minoritätsträger beträgt $L_{\rm n}=60~{\rm \mu m}$. Nehmen Sie für alle Berechnungen schwache Injektion an und gehen Sie davon aus, dass sich die Probe im stationären Zustand befindet. Die Temperatur beträgt $T=300~{\rm K}$ und es liegt Störstellenerschöpfung vor.





- a) Berechnen Sie die Diffusionskonstanten D_n und D_p sowie die Minoritätsträgerlebensdauer τ_n des Halbleiters.
- b) Berechnen Sie den Verlauf der Minoritätsträgerstromdichte $J_n(x)$ im Intervall 0 < x < 6 µm und skizzieren Sie den Verlauf. Verwenden Sie dabei sinnvolle Näherungen und begründen Sie Ihr Vorgehen.
- c) Welche Überschussmajoritätsträgerdichte $p'_p(x)$ und Majoritätsträgerstromdichte $J_p(x)$ stellen sich im stationären Zustand ein? Verwenden Sie sinnvolle Näherungen und begründen Sie Ihr Vorgehen.
- d) Berechnen Sie den Verlauf der Generationsfunktion $g_L(x)$ im Intervall $0 < x < 6 \,\mu m$ unter Vernachlässigung der Rekombination im Volumen des Halbleiters. Gehen Sie davon aus, dass sich die Probe nach wie vor im stationären Zustand befindet.